

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

星宸科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系 活动类别	√ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 人员姓名	信达澳亚、平安基金、华安基金、长城基金、交银施罗德、大家资产、东方红、新华基金、华宝基金、申万菱信、大摩基金、汇丰晋信、兰馨亚洲、前海开源、银河基金、鹏扬基金、渤海人寿保险、华富基金、华夏基金、鹏华基金、中信建投基金、润义投资、乘方投资、歌汝私募、中邮证券、申万宏源、东吴证券、西南证券、中信证券、财通证券、华泰证券、东北证券、兴业证券、山西证券、国信证券、中金公司、国投证券、平安证券、广发证券、国联民生证券、国海证券等 70 家机构与个人
时间	2026 年 8 月 26 日晚间
地点	线上电话会议
上市公司接待人 员姓名	1、董事会秘书兼财务负责人 萧培君 2、市场营销负责人 贺晓明
投资者关系活动 主要内容介绍	公司于 2026 年 8 月 26 日晚间披露了《2026 年半年度报告》，为便于投资者进一步了解公司 2026 年半年度业绩概况、业务亮点、未来展望等，公司于定期报告披露后，会同券商分析师组织举行了特定对象调研，相关记录如下： 一、董秘介绍公司上半年业绩情况 （一）业绩再创新高，研发构筑正向增长循环 2026 年上半年，公司经营业绩逐季攀升，多项核心经营指标刷新历史新高。稳健向好的基本面为持续加码研发投入提供坚实支撑，公司研发投入规模、增速及研发投入率均处于行业前列，持续加速前沿技术落地与增长曲线赛道布局，形成“业绩高增→研发加

	码→技术产品加快迭代→业绩持续兑现”的良性循环。当前公司全力投入 4/6nm 制程产品，推出适配具身智能、边缘推理的百至千 T 算力解决方案，同步研发视觉与 LiDAR 融合的超千线高阶激光雷达芯片，为公司中长期高质量增长筑牢技术底座。 核心经营数据： 报告期内，公司实现营业收入约 26.58 亿元，同比+89.43%；归母净利润约 8.63 亿元，同比+619.50%。 分季度来看，二季度营收 16.64 亿元，同比+125.59%、环比+67.44%；归母净利润 6.43 亿元，同比+834.79%、环比+191.85%。 盈利层面，上半年整体毛利率 55.36%，同比提升 22.17 个百分点；二季度毛利率较一季度环比提升 14.87 个百分点。 研发投入方面，上半年研发费用 4.91 亿元，同比+55.01%、环比+46.59%，预计全年研发投入将突破 10 亿元。 （二）盈利具备内生韧性，产品与客户结构持续优化 针对市场关注的上游原材料、存储周期波动对盈利的影响：若剔除存储等原材料成本上行传导带来的增量收益，公司毛利率同比仍可实现超 10 个百分点的提升。盈利增长核心源于端边侧 AI 需求爆发、中高阶产品占比提升与优质客户结构优化，业绩增长具备扎实主业支撑，盈利质量稳健可持续。 公司业绩增长由出货规模与产品单价同步提升共同驱动，受益于端边侧 AI 行业高景气、产品竞争力持续释放、产品客户结构优化以及稳定的供应链优势。三大业务线全线高速增长： 1. 端边侧 AI SoC：营收 17.64 亿元，同比+104.19%，作为核心增长引擎，增速领跑各业务板块； 2. 汽车电子 SoC：营收 2.68 亿元，同比+77.42%，作为重点布局的第二增长曲线，增长动能强劲； 3. IoT SoC：营收 5.20 亿元，同比+40.52%，依托物联网广阔长尾市场实现稳健增长。 （三）产业链投资双向赋能，产业协同与财务收益共赢
--	--

	公司依托多层次战略投资布局，深度构建全产业链协同生态，实现业务技术协同深化、投资收益增厚的双向价值释放。上游布局 2. 5D/3D 先进封装技术，夯实高性能大算力推理方案的硬件基础；围绕核心主业协同与前沿技术卡位，投资覆盖物理世界模型（拓元智慧）、LPU 架构（元川微）、RISC-V 架构（奥维领芯）等关键赛道。 同时，设立全资子公司福建昇宸（晋江），落地 AI 算力新基建项目，依托区域产能资源搭建产业协同生态，联合落地端边侧推理算力解决方案。 （四）卓越治理与社会责任担当，积极回馈全体股东 在经营快速发展的同时，公司持续完善治理体系、履行社会责任，获得资本市场广泛认可。管理团队先后斩获“福布斯中国最佳 CEO”“新财富金牌董秘”等重磅行业荣誉；报告期内发布公司首份 ESG 报告，在万得、华证两大主流国内 ESG 评级获评 A 级，秩鼎 ESG AA 级、商道绿融 ESG A-级，并入选华证 ESG “2026 年 A 股上市公司首发 ESG 报告优胜 TOP100”。 公益层面，公司积极参与灾害人道救援，先后为香港大埔火灾、广西水灾等灾害捐资助力灾后重建，荣获“中国红十字奉献奖章”“福建省人道金质奖章”。 股东回报方面，伴随本期利润大幅增长，公司积极回馈投资者，2026 年半年度拟实施利润分配预案：每 10 股派发现金红利 6 元，预计分红总额约 2.5 亿元，占当期归母净利润约 30%，与全体股东共享经营成果。 （五）锚定长期愿景，全力冲刺端边侧 AI 算力龙头 公司力争年内保持业绩逐季向好，同时依托高盈利积累以及后续港股上市募集资金，于明后年全面发力，目标三年内打造在营收、利润、研发强度、自研 IP 占比、高阶芯片产品及核心技术等维度全面领先的端边侧 AI 算力龙头。 公司坚持长期主义，以“打造受尊敬的全球一流芯片设计公司”
--	---

为长期愿景，立足“视觉+AI”核心技术框架，发挥“感知+计算+连接”一体化技术优势，持续深耕端边侧 AI 核心赛道。我们将持续以技术创新践行企业责任，也期待各位投资者长期陪伴，公司有信心达成目标愿景，共同分享成长红利。

二、投资人问答环节

Q: 想请教公司，本轮存储芯片价格上涨周期已持续较长时间，想了解在行业供需格局变化下，公司核心的盈利逻辑是什么，盈利弹性主要来自哪些方面？

A: 公司产品定价遵循市场化原则，依托对于上游持续供应确保能力，以及端边侧 AI 行业景气实现价量齐升；若剔除存储等原材料成本上行传导带来的增量收益，公司毛利率同比仍可实现超 10 个百分点提升。盈利增长核心源于端边侧 AI 需求爆发、中高阶产品占比提升与优质客户结构优化，业绩增长具备扎实主业支撑，盈利质量稳健可持续。

1、多元盈利驱动，结构优化为核心增长来源

公司本身定位中高阶芯片方案市场，在供需偏紧的行业环境下，中高端产品的市场接受度与需求韧性反而更强。在产品端，公司主动缩减低毛利方案供给，将产能与资源向诸如 4K 超高清、AI-ISP、端侧 AI 智能感知、低功耗专用等高毛利的中高端产品线倾斜；在客户端，公司战略性退出对价格高度敏感的低阶市场，重点保障各业务线的头部品牌、海外渠道等有溢价能力、保供需求强的优质客户，客户质量的提升进一步拉动了整体盈利水平。

2、深度绑定头部品牌客户，产业共生实现共赢

本轮存储行业供需格局变化是全产业链共同面对的趋势，公司与下游头部品牌客户保持长期深度绑定，凭借稳定的供应链整合与保供能力，保障核心客户的稳定交付与产品品质底线，共同维护终端市场的品牌口碑。伴随行业趋势演进，下游客户产品持续向中高端迭代，迭代方向涵盖画质规格升级、AI 智能化升级、场景化创

新升级、存储架构适配升级等维度；公司芯片可同步匹配客户升级节奏输出对应高阶方案，双方产品结构同步优化，形成利益一致的产业共生格局。

3、动态策略应对周期，规模优势筑牢长期韧性

存储行业本身具备周期性特征，未来供需与价格走势仍存在一定不确定性，公司依托自身规模及供应链稳固关系，有信心做到业界保供能力最强，并能灵活调整备货与供给节奏，平滑周期波动对经营的影响。与此同时，公司业务规模优势突出，上游供应商高度认可公司的长期成长空间与订单稳定性，在供需紧张阶段会给予公司优先支持，形成“规模优势—供应韧性—客户价值”的正向循环，持续夯实公司长期经营韧性。

Q：随着端边侧 AI 应用加速落地，行业竞争也日趋激烈。请问，与其他 SoC 企业相比，公司在端边侧 AI 领域的核心差异化优势主要体现在哪些方面？

A：公司在端边侧 AI 领域的差异化优势，主要建立在长期积累的视觉感知能力、覆盖多层级需求的端侧 AI 算力矩阵，以及“感知+计算+连接”的技术协同布局之上。

1、视觉感知的长期积淀与平台化复用

在端边侧 AI 的竞争，公司最深的护城河来自长期积累的视觉感知能力。视觉感知是具身智能机器人、智能家居和车载智能系统实现环境理解与自主交互的重要入口。作为全球领先的视觉 AI SoC 芯片设计企业，公司长期以“视觉+AI”为核心能力，形成涵盖 ISP、双目测距、LiDAR、IVE 及多传感融合的自研技术矩阵，能够从环境光还原到三维空间感知、从单摄像头到多传感器协同，提供完整的端侧感知支撑。在具体的技术演进上，公司星帷 ISP 图像处理引擎持续迭代，目前已迭代至 ISP6.0 版本，已从传统 ISP 升级至 AI ISP，突破超星光夜视、高宽动态、多目拼接、运动稳定四大核心能力；为支撑机器人从 2D 感知跨越到 3D 感知，公司布局双目 3D 成像与 LiDAR SoC，探测距离覆盖 0.5m~300m、精度达

	±0.03m，并配套多 MIC 阵列听觉方案与高速 ADC/PWM 触觉感知（8bit 至 24bit 精度），形成覆盖视、听、触的多维感知力。 与此同时，公司视觉 IP 具备高程度的平台化复用能力，可高效迁移至车载舱内外视觉感知、具身智能机器人、智能家居等场景。因此，视觉不只是单项技术，而是贯穿公司产品与解决方案的底层主线。公司已在视觉感知层构筑起难以复制的技术壁垒，使视觉成为公司区别于其他厂商的根本性差异。 2、全栈端侧 AI 与弹性算力 公司围绕端边侧 AI 的算力需求，构建“主控 SoC+算力协处理器”的全梯度算力芯片矩阵。制程向 12nm 及以下先进节点持续演进，NPU 算力规格逐代提升，可覆盖从 1.5B 到 30B 主流端侧大模型的高效推理部署，支撑从 CNN、Transformer 到 LLM、VLA 的多类端侧 AI 负载。依托自研主控 SoC、算力协处理器及外部协同，公司是业内算力矩阵最丰富、算力弹性最大、产品适配最灵活的企业之一。 公司算力芯片产品矩阵的具体演进路径如下： SSR670G 系列是公司当前已实现量产的入门级边缘计算产品，采用 6 核 CPU 与 8TOPs 算力配置，已率先在具身智能的无人零售场景实现商用落地，也已在多类边缘计算场景获得市场认可，验证了公司新一代端边侧算力产品的竞争力与交付能力。 下一代大算力中阶主控芯片采用 12nm 工艺、8 核 CPU 架构，算力提升至 16 - 32TOPs 级别，图像效果达 32×1080p@30，并支持 LPDDR5X 高容量内存，将于下半年投片、明年可实现商用落地。 公司同步规划中的大算力高阶协处理器芯片将采用更先进的 4/6nm 制程工艺，单颗 NPU 算力达百至千 T 规模级别，并采用先进封装方案以实现超高带宽能力，突破大算力芯片的带宽瓶颈，支撑端侧大模型与多模态推理的规模化部署。 在自研算力矩阵之外，公司通过战略投资元川微 LPU 架构，获得更高阶的大算力协同能力。元川微采用原生 LPU 架构打造大算力
--	---

	芯片，一套架构灵活覆盖云、边、端场景，其算力规格定位将成为公司算力矩阵的最高阶补充，与自研的入门级、中阶、高阶形成梯度接力，进一步完善面向大模型与多模态推理的端边侧算力版图。 在具备全梯度弹性算力的基础上，公司持续从“单一芯片销售”向“算力板卡和整体解决方案交付”延伸，并同步成立生态与解决方案 BU，推动芯片能力向标准化算力产品、软硬一体方案和行业场景交付转化。相关方案可由主控 SoC、大算力芯片、大容量存储、硬件板卡及模型和系统软件适配等环节组成，面向具身智能、车载 AI Box、AI NAS/Homebase、AI NVR/XVR 和企业级算力中心等场景提供整体算力支持，降低客户开发与部署门槛，推动端边侧 AI 从芯片能力向产品化、平台化和场景化交付延伸。 3、感知、计算与连接的协同能力 公司的差异化能力还体现在感知、计算与连接三类技术的协同布局上。在感知前端，公司布局 3D ToF 及激光雷达 SPAD-SoC，覆盖车载和机器人等对高精度空间感知有要求的场景，并通过双目 3D、多传感融合等技术提升设备对距离、深度、目标位置和环境变化的理解能力；在计算后端，公司以视觉 AI SoC、端边侧主控 SoC 及大算力芯片承接图像处理、模型推理和智能决策，使前端采集的数据能够在设备本地完成分析和响应，满足低延迟、低功耗及数据安全等端侧部署需求；在连接侧，公司通过控股子公司富芮坤的低功耗蓝牙芯片能力，协同覆盖智能家居、车载出行、工业通信和智能穿戴等应用，推动感知设备、算力终端与周边设备之间实现稳定连接和数据交互。 由此，公司能够将前端感知、边缘计算与终端连接放在同一套技术和产品体系中，形成从数据获取、端侧推理到设备协同的完整链路，并进一步服务于“芯片+平台+生态”一体化战略。 Q：关注到公司在定期报告中披露于晋江设立全资子公司福建昇宸科技有限公司，请问该子公司的主要定位是什么？和当地的产业资源是否会有协同？
--	--

	A：在本地产业链配套方面，公司晋江设立全资子公司“福建昇宸科技有限公司”，落地 AI 算力新基建项目，聚焦端边侧算力解决方案如算力板卡等边缘 AI 推理所需的设计、研发与规模化量产，产品覆盖 AI NVR/NAS、企业级算力中心、车载空间超级助手、服务机器人及具身智能机器人等多元场景。该项目可联动本地半导体产业资源，与公司自研高性能大算力芯片形成优势互补，构筑端边侧算力系统核心部件的技术壁垒，在当地打造 AI 端边侧算力产业链底座，持续强化公司从芯片到整体算力解决方案的纵向一体化整合能力。 Q：关注到公司在定期报告中采用了新业务分类，将原来的智能安防/智能物联/智能车载重新分类为端边侧 AI/IoT/汽车电子，请问是基于什么考虑？如何理解端边侧 AI 和 IoT 之间的区别？ A：本次新业务分类，不涉及公司主营业务的变化。核心是顺应公司在端边侧智能技术及产品的演进成长趋势，以应用场景的智能化层级与核心技术属性为区分标准，替代原有的终端品类划分方式，更精准地匹配公司技术布局节奏与市场结构变化，便于投资人清晰理解不同业务板块的成长属性与价值逻辑。 1、智能迭代与功能升级 关于端边侧 AI 与 IoT 的区别，本质对应智能终端从基础互联向深度智能演进的不同发展阶段。 IoT 业务面向成熟的传统物联场景，对应终端联网化的初级阶段，核心是实现设备互联互通与基础功能交付；算法层面以预设规则的传统计算逻辑为主，依托 CPU 等通用算力即可运行，依靠固定程序完成标准化的数据采集与指令响应，算力需求低，应用形态成熟、需求长尾稳定。 端边侧 AI 面向高景气新兴应用场景，对应终端智能化的进阶阶段，核心特征是人工智能兴起，模型小型化加速，智能从云端向设备端加速下沉，轻量化的模型走进各类智能终端；算法层面以 CNN、Transformer 等神经网络模型的端侧硬件加速为核心，依托
--	--

	专用 NPU 算力单元在本地完成高精度推理与智能决策,设备具备环境感知、智能研判、自主交互的深度智能能力,不再依赖人工指令触发与云端强联动。其技术升级维度涵盖 AI-ISP、端侧 AI 智能感知与交互升级、垂直细分场景专用化拓展、异构存储架构定制化适配等方向,典型场景包括智能机器人、家庭智能体、带 AI 语义分析的智能 IPC、边缘计算等,对芯片的视觉效果、NPU 算力、多模态感知、低功耗能效比均提出了更高要求。 公司拥有业内覆盖度领先的芯片产品矩阵,型号谱系完整、细分定位精准,可适配不同智能化层级的多元场景。本次分类正是基于芯片的技术规格、算力等级与适配场景对应划分,也客观反映了公司产品结构的持续升级进程。 2、战略契合与业务协同 本次划分也与行业发展大势及公司长期战略高度契合。当前计算重心持续从云端向端边侧下沉,端边侧 AI 已成为智能硬件产业升级的核心主线。公司的核心战略定位正是成为领先的端边侧 AI SoC 企业,目前主营业务方向定位清晰、协同发展:端边侧 AI SoC 聚焦智能家居、智能机器人、智能 IPC、边缘计算等高景气新兴应用,是公司拓展增长空间的核心引擎;IoT SoC 面向多元化长尾物联场景,依托广泛的产品谱系与成熟的客户基础筑牢公司经营基本盘;汽车电子 SoC 围绕舱内外视觉感知、智能辅助驾驶需求展开,叠加今年上半年已落地陆续放量的激光雷达 SPAD-SoC,推动视觉感知能力向车载多模态感知延伸。 公司主营业务方向既各有侧重,又共享公司在视觉、AI 处理器(NPU)、3D 感知、连接等底层 IP 及客户、供应链等方面的积累,推动公司从既有技术与市场优势出发,持续向高景气端边侧 AI 应用纵深拓展。
风险提示	以上涉及行业预测、公司发展战略规划等相关内容,不视为公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。
是否涉及应当披	否

露的重大信息	
附件清单（如有）	无
日期	2026-08-26